

ブース出展のご案内

日本シエムケイは、2016年1月13日～15日に開催される“NEPCONジャパン2016”の『カーエレクトロニクス技術展』と『プリント配線板EXPO』に出展致します。
本展示会では自動車をはじめ、民生・産業・医療機器とあらゆる分野に向けた各種プリント配線板をご紹介します。
当社ブースへのご来場を心よりお待ちしております。

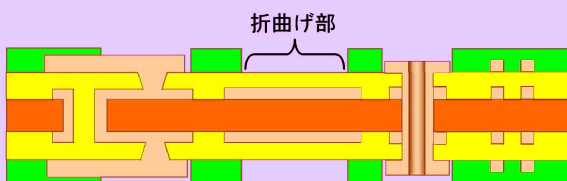


会期：2016年1月13日[水]～15日[金] 会場：東京ビッグサイト

**ウェアラブル端末に
最適!**

高密度薄型多層 FPC

- ・4層で部品実装部厚み0.18mm
- ・BVH(フィルドビア)構造により高密度化を実現



みどころ!



第8回 **国際カーエレクトロニクス技術展**

高周波対応配線板

- ・低 Dk/Df 基材を採用し、ミリ波レーダーなどの高周波用途に対応します



SEPT® シリーズ

- ・実装信頼性がさらに向上した、はんだクラック抑制配線板



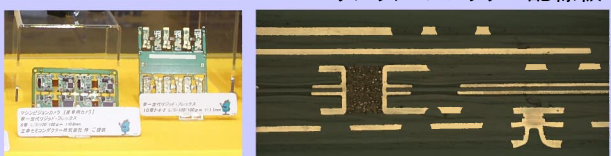
CARFT® シリーズ

- ・エンジン直載レベルの信頼性を達成したリジッド・フレックス配線板



1G-RF

- ・車載カメラモジュール向けの信頼性を達成したリジッド・フレックス配線板



西1ホール 小間番号:W5-9

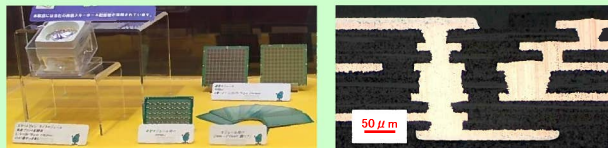
みどころ!



第17回 **プリント配線板 EXPO**

PPBU® (薄型モジュール対応)

- ・ガラスクロスを全層に使用し、薄型と高信頼性を両立
- ・エニーレイヤー構造を採用し、小型化を実現



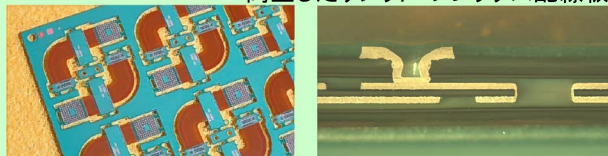
2G-RF

- ・究極の薄型化を達成したリジッド・フレックス配線板



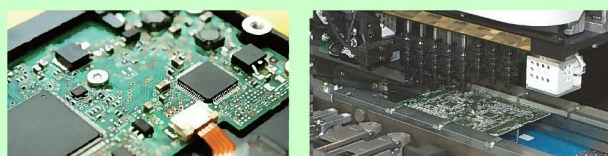
1G-RF (高剛性・ハロゲンフリー対応)

- ・モジュール用途向けに薄型化と高剛性を両立したリジッド・フレックス配線板



PCBA

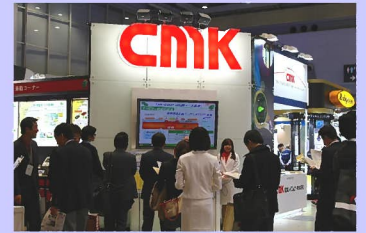
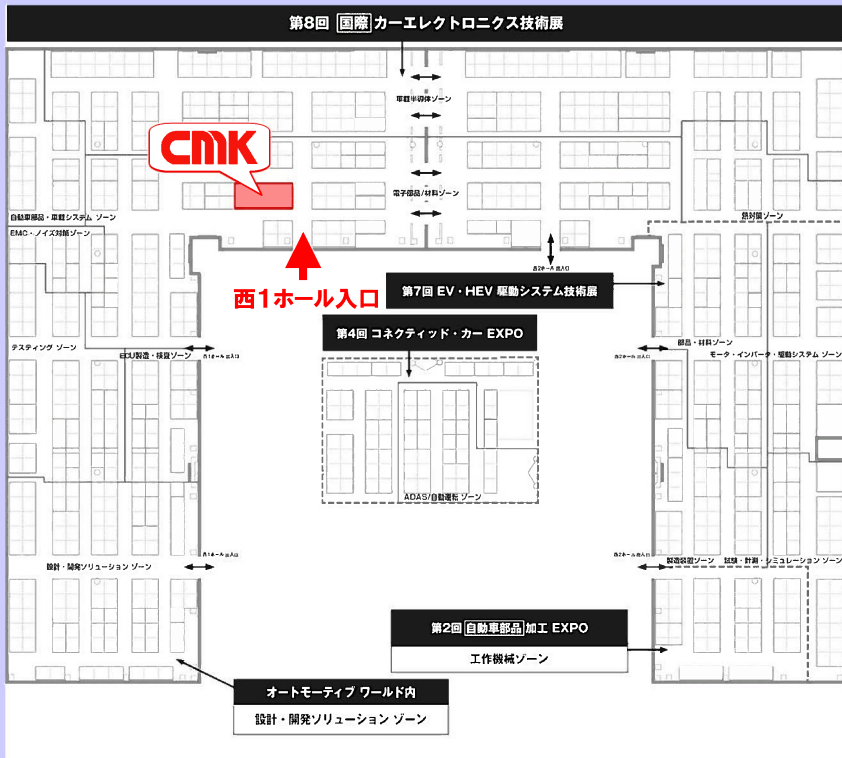
- ・プリント配線板の設計・製造から実装までをサポートいたします



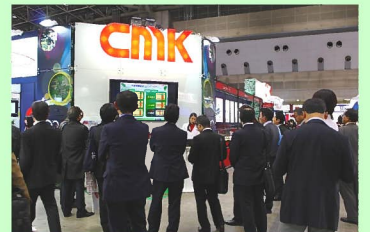
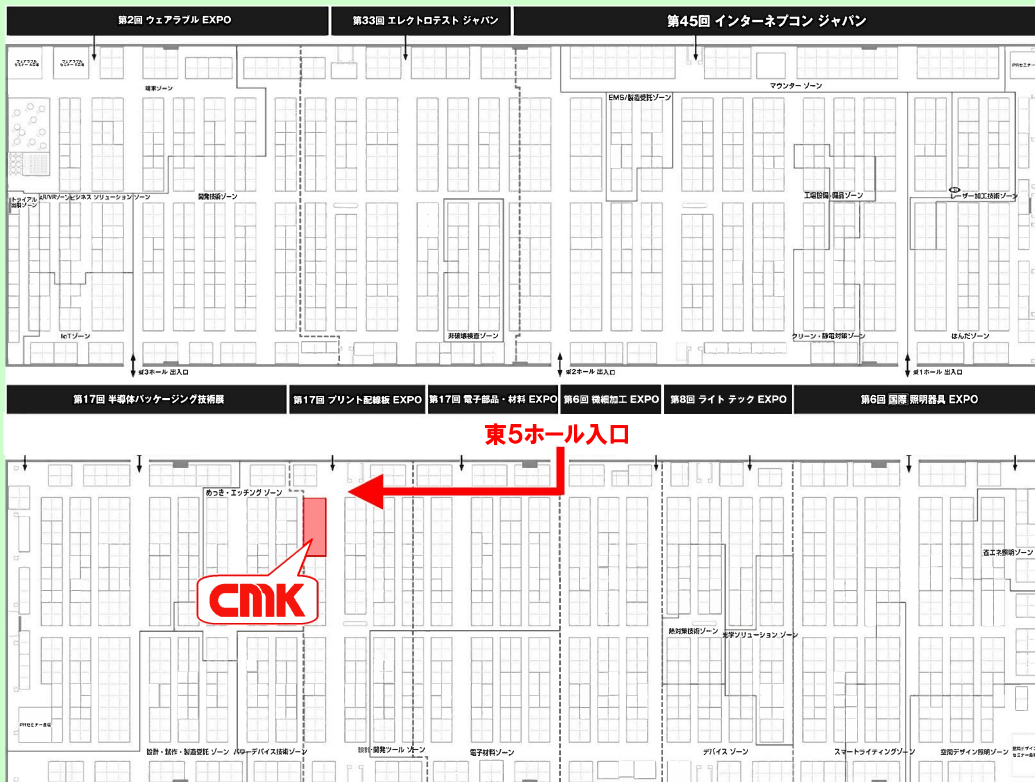
東5ホール 小間番号:E50-4

日本シイエムケイ出展ブースのご案内

第8回 国際カーエレクトロニクス技術展 西1ホール 小間番号:W5-9



第17回 プリント配線板 EXPO 東5ホール 小間番号:E50-4



『当日は新技術を中心としたプレゼンテーションも実施致します。是非 CMK ブースへお立ち寄り下さい』

CMK 日本シイエムケイ株式会社